

中国国际金融股份有限公司

关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2023 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“龙迅股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责龙迅股份的持续督导工作，并针对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）经营情况，出具本持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与龙迅股份签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解龙迅股份业务情况，对龙迅股份开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	在持续督导期间龙迅股份未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施	在持续督导期间龙迅股份未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各	在持续督导期间，保荐机构督导龙迅股份及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和

序号	工作内容	持续督导情况
	项承诺	上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促龙迅股份依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、控股子公司管理等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对龙迅股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，龙迅股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促龙迅股份严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对龙迅股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	本持续督导期间，龙迅股份及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，龙迅股份及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	本持续督导期间，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司作出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他	本持续督导期间，龙迅股份未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
	不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应当自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	本持续督导期间，龙迅股份不存在前述情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术迭代风险

公司所处的集成电路设计行业具有技术密集型的特征，市场需求的不断升级、产品技术的持续迭代是行业发展的重要规律。公司主营业务所在的高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片细分领域的技术与方案伴随着终端需求的变化也不断推陈出新。公司需要持续不断地推出符合技术发展方向与市场需求趋势的新产品才能维持并提升公司的竞争力。如果未来公司技术迭代创新和产品升级换代未达到预期，难以满足市场需求的最新变化，可能会使得公司在市场竞争中处于不利地位，逐渐丧失市场竞争力，对公司未来业务发展造成不利影响。

2、研发失败风险

公司主营业务为高清视频桥接及处理芯片与高速信号传输芯片的研发设计与销售。公司需要结合技术发展和市场需求确定研发方向，持续进行现有产品线的升级与新产品的开发，以适应不断变化的市场需求，并持续投入大量的资金和人员进行研发。由于新技术与产品的研发与产业化具有一定的不确定性，如果公司的研发创新方向与行业发展趋势出现较大偏离，或相关研发成果短期内无法产业化，公司将面临研发失败的风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

经过十多年来持续的技术积累，公司储备了一系列拥有自主知识产权的核心技术。如未来因研发人员流失、关键信息泄露、核心技术保管不善等因素导致核心技术泄密，将对公司业务造成不利影响。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧风险

公司业务所处领域整体有较高的技术壁垒，需要长时间的技术积累，而中国大陆企业在该领域起步相对较晚，目前市场竞争格局仍主要由境外公司所主导，公司各类产品目前国产化率尚处于较低水平。公司相较于海外领先竞争对手，在整体规模、研发实力、营销网络、客户资源、融资渠道等诸多方面仍存在差距。同时，随着中国半导体产业整体设计能力的进步，公司也会面临本土芯片设计公司在细分产品市场的竞争。在日趋激烈的市场竞争环境下，若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术升级、提高产品性能与服务质量，竞争决策失误、市场拓展不力，则公司的市场地位与经营业绩等可能受到不利影响。

2、贸易摩擦及贸易政策变动风险

报告期内，公司境外销售比例较高，主要集中在中国香港、中国台湾、韩国、日本等国家或地区。同时，公司晶圆制造及封装测试境外采购比例高，主要集中在马来西亚、中国台湾。未来如果全球贸易摩擦加剧，相关国家或地区采取限制性的贸易政策，境外客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相关关税等

措施，境外供应商可能会被限制或禁止向公司供货，上述情况会对公司的正常生产经营产生不利影响。

3、供应商集中度高风险

公司采用 Fabless 经营模式，专注于芯片的研发设计和销售，生产环节主要委托晶圆生产厂和封装测试厂进行制造加工。报告期内，公司向前五名供应商采购金额占同期采购总额的比例相对较高，供应商整体集中度较高；其中，境外晶圆供应商主要有 SILTERRA MALAYSIA SDN. BHD.和联华电子股份有限公司，境外封测供应商主要有超丰电子股份有限公司，境外供应商占比及集中度较高。未来若公司合作的主要供应商因贸易摩擦、排期紧张或者关系恶化等各种原因不能如期、足量供货，从而对公司生产经营造成不利影响。

（三）财务风险

1、收入波动及未来业绩快速增长不可持续的风险

公司业务规模增长受下游需求增长影响较大，若整体宏观经济及半导体行业持续波动、产业政策发生重大不利变化，公司产品涉及的安防监控、教育及视频会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC 及周边等下游应用需求下降，公司未能及时判断下游需求变化，可能对公司的销售收入和经营业绩产生不利影响。同时，产品和技术升级迭代及市场竞争格局变化也将对公司业绩产生影响，若公司技术实力停滞不前、市场竞争加剧或市场环境发生重大不利变化，可能导致公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形，公司存在未来业绩快速增长不可持续、业绩大幅波动或下滑的风险。

2、毛利率波动风险

公司产品毛利率主要受下游需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本、公司设计能力、竞争格局等多种因素影响，若上述因素发生不利变动，可能导致公司毛利率下降，从而影响公司盈利能力。

3、存货余额较大及减值风险

报告期末，公司存货账面价值为 6,775.63 万元，占公司总资产比例为 4.77%，相较于上年末，存货规模与占比均有所下降。公司产品品类丰富、应用领域广、生产周期较长等因素决定公司需保持较高规模的存货储备。公司存货的账面价值金额较大，如果下游市场需求下降或晶圆等原材料价格出现大幅下跌，公司将面临大幅计提存货跌价准备的风险，导致公司经营业绩下滑，给公司生产经营和财务状况带来不利影响。

4、汇率波动风险

公司存在境外采购和销售，并通过美元进行结算。未来若人民币与美元汇率发生大幅波动以及未来公司经营规模持续扩大后以美元计价的销售额和采购额进一步增长，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起公司利润水平的波动，对公司未来的经营业绩造成不利影响。

（四）行业风险

半导体行业是国民经济和社会发展的战略性产业，国家出台了一系列鼓励政策以推动我国半导体行业的发展，增强行业创新能力和国际竞争力。若未来国家相关产业政策支持力度减弱，将对公司发展产生一定影响。

（五）宏观环境风险

1、半导体行业周期性及政策变化波动风险

公司处于集成电路设计行业，半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，与宏观经济及下游应用市场需求波动有较大关联，同时国家政策对行业的发展亦有较大影响。2022 年以来，受世界经济呈现衰退态势、消费电子周期需求下行及国际局势紧张等多重影响，半导体行业进入下行周期，截至目前没有明显的复苏迹象。公司产品应用领域中包括显示器、安防监控、视频会议、PC 及周边等领域需求均不同程度受到本轮下行周期及宏观经济形势影响。如果未来集成电路设计行业的产业政策发生重大不利变化，或在半导体行业下行周期出现持续时间较长、波动较大的情况，则可能将对公司的经营业绩造成不利影响。

2、税收优惠政策变动风险

公司作为高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业，可享受 10% 的企业所得税优惠税率。若国家相关税收优惠政策发生变化，或者公司未能持续获得高新技术企业及国家鼓励的重点集成电路设计企业认定，则可能面临因税收优惠减少或取消而导致盈利能力下降的风险。公司 2023 年 5 月再次被认定为国家鼓励的重点集成电路设计企业，2023 年企业所得税继续按照 10% 税率征收。

（六）其他重大风险

1、法律风险

（1）知识产权相关风险

公司拥有的商标、专利等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。随着高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片及相关领域市场竞争日趋激烈，公司未来仍可能出现知识产权被第三方侵犯、知识产权涉及侵权诉讼或纠纷等情形。如果公司通过法律途径寻求保护，将为此付出额外的人力、物力及时间成本，从而导致公司商业利益受到一定程度的损失。如公司相关核心技术被竞争对手所获知并效仿，或者第三方侵犯公司知识产权的行为得不到及时防范和制止，可能对公司未来业务发展和生产经营产生负面影响。

（2）产品质量相关风险

随着公司经营规模的持续扩大，对质量控制能力的要求逐步提高，如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，公司产品出现质量问题，可能导致与客户发生潜在诉讼或纠纷，影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

2、内控风险

（1）经营规模扩大带来的管理风险

公司的经营规模持续扩大，随着公司业务持续发展和募投项目的实施，公司的收入和资产规模会进一步扩大，从而在资源整合、资本运作、市场开拓等方面对公司的管理层和内部管理水平提出更高的要求。如果公司管理层业务素质及管理水平

不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能及时调整、完善，公司将面临较大的管理风险。

(2) 内控制度建设和执行的风险

内部控制制度是保障企业财产与会计信息的完整性、安全性以及可靠性的关键制度。如果公司未来不能随着业务人员的发展而及时调整完善有关内部控制制度及体系，或者有关内部控制制度不能有效地贯彻和落实，将影响企业管理的有效性，不利于维护公司财产安全并保持经营业绩的稳定增长。

3、预测性陈述存在不确定的风险

公司在 2023 年半年报中所涉预测性的陈述，例如涉及公司所处行业的未来市场需求、公司未来发展规划、业务发展目标、财务状况、盈利能力、现金流量等方面的预期或相关讨论。尽管公司及公司管理层相信，该等预期或讨论所依据的假设是审慎和合理的，但亦需要提请投资者注意，该等预测性陈述仍有较大不确定性。鉴于该等预测与讨论均有风险及不确定性因素，公司 2023 年半年报载明的任何预测性及前瞻性陈述，不应被视为公司的承诺与声明。

4、股票价格波动风险

股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影响，还会受到宏观经济基本面、资本市场资金供求关系、投资者情绪、国外经济社会波动等多种外部因素的影响。公司股票价格可能因上述而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

四、重大违规事项

2023 年 1-6 月，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	2023年1-6月	2022年1-6月	增减变动幅度(%)
营业收入(元)	133,926,790.12	122,201,572.35	9.59
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,949,780.97	40,416,578.08	3.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,136,449.33	31,721,574.57	-11.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,375,913.54	38,038,885.37	40.32
主要会计数据	2023年6月30日	2022年6月30日	增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,368,286,332.20	316,162,198.27	332.78
总资产(元)	1,421,484,576.42	359,687,379.31	295.20

主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.66	0.78	-15.38
稀释每股收益(元/股)	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.61	-27.87
加权平均净资产收益率(%)	4.11	14.65	减少10.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.76	11.50	减少8.74个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	22.37	21.93	增加0.44个百分点

2023年上半年，公司实现营业收入13,392.68万元，较上年同期增长9.59%，主要系报告期内公司坚持以市场和客户需求为导向，持续加大研发投入和业务拓展力度，不断推出新产品并进一步优化产品结构，综合竞争优势得到强化和提升，订单及收入均比去年有所增长所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长40.32%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

归属于上市公司股东的净资产与总资产分别较上年同期增长332.78%、295.20%，主要原因为报告期内公司首次公开发行股票，募集资金到账。

六、核心竞争力的变化情况

1、长期技术积累和持续创新能力优势

公司现有产品主要分为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片两大类。公司产品主要实现高清视频信号的桥接、处理、传输等功能，具有较高的技术门槛。通过长期坚定的研发投入，公司在高速混合信号电路及芯片集成、高速数据传输芯片收发、高速接口传输协议处理兼容性、高带宽数字内容保护、高清视频及音频处理等方面积累了丰富的研发经验和技術能力，在高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片领域构筑了较强的竞争壁垒。上述技术优势使得公司在主流协议覆盖面与兼容性上具备国际竞争力，公司芯片产品线可覆盖市场绝大多数主流高清视频信号协议，可支持多个主流高清视频协议的业内最高版本，在其他主要功能上也具备一定的技术优势。

公司始终将研发创新能力视为企业发展的重要目标，持续创新能力是公司重要的竞争优势。为保持公司能够持续不断的进行技术创新，公司研发投入长期维持在较高水平，同时以市场和客户需求为创新导向，建立了科学的项目开发和管理体系，制定了规范的知识产权管理制度，对人才培养、考核和激励进行了长远规划。一系列的举措使得公司拥有了良好的持续创新机制，以在技术不断迭代的市场中保持竞争力。

2、结构丰富且具备市场竞争力的产品优势

公司成立以来始终以市场为导向，致力于提供高性能的高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片产品。通过多年市场耕耘，公司目前已拥有超过 140 款不同型号的芯片产品，可全面支持 HDMI、DP/eDP、USB/Type-C、MIPI、LVDS、VGA 等多种信号协议，产品性能稳定、可靠。公司多款高清视频桥接及处理芯片不仅支持上述信号协议之间转换，还集成了视频图像的分割、缩放、旋转、存储、压缩、解压、色彩空间转换与增强、显示控制，背光控制等处理功能，高速信号传输芯片在对各类信号高速传输的过程中，能实现中继、分配、切换和矩阵交换等功能，可为客户提供多样化的芯片解决方案。公司在高清视频桥接芯片与高速信号传输芯片产品上结构全面、功能丰富，可以满足下游客户对芯片产品高性能和高集成度的需要，具有较强的市场竞争力。

近年来，公司基于在相关细分领域的长期技术积累不断实现产品的高效迭代，并根据对市场需求的深度理解持续提出具有创新性的芯片解决方案，不断丰富产品线和优化产品结构，以维持并扩大在高清视频桥接芯片、高速信号传输芯片等细分领域的产品竞争优势。

3、优质品牌价值与客户服务优势

公司通过多年来在高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片领域的持续深耕，已逐步在产业链内形成了优质的品牌声誉。随着公司芯片产品种类和规格的不断丰富、升级和系列化，可支持应用场景的不断多元化，公司的技术能力与产品性能正不断受到知名客户的广泛认可，客户结构持续优化。公司已成功进入国内外多家知名企业供应链。同时，多家世界领先的主芯片厂商已将公司产品纳入其部分主芯片应用的参考设计平台中。

公司高度重视加强规范管理和品质提升，以期为客户提供高品质的服务。公司及时主动的了解和响应客户的需求和产品使用中的痛点，积极为市场迭代更为完善的解决方案，近年来逐步与众多下游知名客户建立了深度的合作关系。公司对于高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片的长期聚焦使得公司在该细分领域拥有更为高效的产品竞争力和客户服务能力。同时，公司重视在与头部客户的交流合作中不断了解市场前沿的需求变化，通过技术和产品创新实现品牌价值的持续提升。

4、管理与研发团队优势

公司高度重视管理与研发团队的建设和人才的培养。公司董事长 FENG CHEN 博士曾在英特尔公司任职，主要从事高速 CPU、I/O 等芯片设计工作。公司管理团队具有丰富的集成电路产业经验，具备扎实的专业能力和丰富的管理经验。公司自成立以来，在管理团队的带领下，获得了“国家鼓励的重点集成电路设计企业”、“国家重点‘小巨人’企业”、“国家专精特新中小企业”、“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”等多项荣誉与资质。

公司研发团队由公司核心创始研发团队、后期引进的具有丰富集成电路设计经验的研发人员和自主培养、快速成长起来的年轻工程师组成，富有创造力的高素质优秀人才梯队，为公司未来持续技术创新提供了强有力的支持。截至 2023 年 6 月

30日，公司共拥有120名研发人员，合计占员工总数比例为66.30%。公司自成立以来，长期坚持研发投入，在高清视频桥接及处理芯片、高速信号传输芯片领域构筑了较强的竞争壁垒。截至2023年6月30日，公司已获得境内专利94项（其中发明专利为72项），境外专利40项（全部为发明专利），集成电路布图设计专有权111项，软件著作权102项。

5、精益求精的质量管理体系

公司按照半导体集成电路行业的国际标准建立了严格、完善的品质保障体系，在产品的设计研发、晶圆制造、封装测试和成品管理等各个环节建立了相应的质量保障流程和标准，并由各部门负责人严格监督执行到位，以确保产品品质。在产品性能方面，公司的芯片产品普遍具有高集成度、高性能、低能耗的优势。

七、研发支出变化及研发进展

1、研发支出及变化情况

报告期内，公司持续加大研发投入，紧密追踪市场需求，针对性地提升了产品性能和核心技术水平。

2023年1-6月，公司研发费用为2,996.01万元，较2022年同期增长11.79%；研发费用占营业收入的比例达到22.37%。

2、研发进展

公司坚持深耕于高速混合信号芯片领域，不断发展高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的技术并进行产品迭代，已掌握了多项国内领先或达到国际先进水平的核心技术。公司高度重视研究成果，不断通过申请专利和集成电路布图设计或制定严格的保密程序对技术予以保护。截至报告期末，公司应用在产品中的核心技术均通过自主创新形成，其中高速接口传输协议处理技术、高带宽数字内容保护技术达到国际先进水平，高速混合信号电路及芯片集成技术、高速数据传输芯片收发电路技术、高速混合信号芯片量产测试技术处于国内领先水平，高清视频及音频处理技术处于国内先进水平。报告期内，公司持续加大研发投入，紧密追踪市场需

求，针对性地提升了产品性能和核心技术水平。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 205 项，其中发明专利 182 项，占比 88.78%；授权专利 134 项，其中发明专利 112 项，占比 83.58%。报告期内，公司新增申请专利 3 项，均为发明专利；新增获授权专利 5 项，均为发明专利。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计已实际使用募集资金 61,301,330.40 元。募集资金余额为 296,552,212.08 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

具体情况如下：

	单位：元
募集资金净额	1,030,280,987.25
减：本年度直接投入募投项目	33,799,760.57
置换前期投入募投项目	27,501,569.83
报告期末现金管理余额	710,000,000.00
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额	5,148,221.79
置换前期投入募投项目和已支付发行费用	32,424,333.44
期末募集资金账户余额	296,552,212.08

注：公司于 2023 年 6 月 30 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,750.16 万元及置换已支付发行费用的自筹资金人民币 492.28 万元（不含增值税）。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-016）。截止到报告期末，上述资金暂未从募集资金账户中转出。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	1302011129100273322	22,779,820.91	
交通银行股份有限公司安徽省分行	341301000013001930939	84,354,253.41	
招商银行股份有限公司合肥望湖城支行	551903525810903	166,582,829.64	
合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行	20010339250866600000011	22,835,308.12	
合 计		296,552,212.08	

公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

1、持股情况

2023 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人及现任董事、监事和高级管理人员的直接持股情况如下：

姓名	职务	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	报告期内增减变动
FENG CHEN	董事长、总经理、核心技术人员	25,947,884	25,947,884	0
刘永跃	董事、副总经理	249,331	249,331	0
苏进	董事、副总经理、核心技术人员	224,400	224,400	0
高泽栋	董事	0	0	0
贾冰雁	董事	0	0	0

姓名	职务	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	报告期内增减变动
刘启斌	董事	0	0	0
吴文彬	独立董事	0	0	0
杨明武	独立董事	0	0	0
李晓玲	独立董事	0	0	0
杨帆	监事会主席	0	0	0
高云云	监事	0	0	0
周大锋	职工代表监事	0	0	0
赵彧	董事会秘书	0	0	0
韦永祥	财务负责人	0	0	0

除上述直接持股情况外，公司董事长、总经理、核心技术人员 FENG CHEN，董事、副总经理、核心技术人员苏进，监事高云云、周大锋，高级管理人员赵彧、韦永祥通过芯财富间接持有公司股票。报告期内，FENG CHEN、苏进、高云云、周大锋、赵彧、韦永祥通过芯财富分别间接持有公司股票 1.61 万股、4.47 万股、2.29 万股、5.18 万股、3.74 万股、2.89 万股，报告期内未发生变动。

同时，公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所科创板上市，FENG CHEN、刘永跃、苏进、高云云、周大锋、赵彧通过中信建投基金-共赢 15 号龙迅股份员工参与战略配售集合资产管理计划分别间接持有公司股票 15.36 万股、1.84 万股、1.84 万股、10.29 万股、3.99 万股、2.07 万股，截至报告期末未发生变动。

2、质押、冻结及减持情况

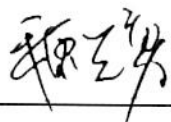
截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人及现任董事、监事和高级管理人员持有的上述股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:



魏先勇



占海伟

